

8月7日に専門家を招聘し、「半導体」をテーマに 「SHARP Tech-Forum」を開催



シャープは、創業111周年記念イベント「SHARP Tech Day」（本年11月11日開催）にあたり、先行イベントとして、昨今産業界で大きな関心を集める「半導体」をテーマにした「SHARP Tech-Forum」を開催します。

「半導体」は次世代通信技術・AI応用・ロボティクスの進展等の社会イノベーションを支える基盤技術であり、各国で戦略的な取り組みが行われ、世界中の企業や研究機関でも活発に研究開発が進められています。

日本においても、米中貿易摩擦や経済安全保障上の観点から国内生産の重要性が高まっており、政府が後押しするなど、半導体技術の国内回帰の動きが加速しています。

そこで、本フォーラムでは、最新の業界動向や将来展望をお届けすべく、「産学官」の第一線でご活躍される国内外の専門家をお招きし、3つの講演と、講演者を交えたパネル・ディスカッションを実施いたします。以下をご確認の上、是非ともご参加ください。

■ 「SHARP Tech-Forum」特設サイト

<https://corporate.jp.sharp/info/notices/techday/forum2308>

■ イベント概要

日 時：2023年8月7日（月）16時00分～17時15分（第1部）
17時25分～18時30分（第2部）

会 場：①現地参加：東京国際フォーラム 7階 ホールD7（東京都千代田区丸の内3-5-1）
②オンライン参加（第1部のみ配信予定です）

参加費用：無料

参加申込方法：上記の「特設サイト」より、お申し込みください。現地参加はお申し込み多数の場合、抽選となります。

また、事前にお申し込みが無い場合はご参加いただけませんので、ご注意ください。

■ プログラム

<第1部>

- 講演1：鴻海グループ最高半導体戦略責任者 蔣尚義 氏／「集積回路から集積チップレットへ」
- 講演2：大阪大学 名誉教授 菅沼克昭 氏（大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装協働研究所長）／「協働で拓く次世代半導体実装技術」
- 講演3：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 金指壽 氏／「グローバル時代を勝ち抜く半導体産業戦略の展望」

<第2部>

パネル・ディスカッション：「AI時代におけるユーザーニーズとLSI技術の方向性」

<パネラー> 蔣氏、菅沼氏、金指氏ほか

<ファシリテーター> シャープ株式会社 常務 研究開発本部長 種谷元隆

●パネル・ディスカッション終了後、参加者からのQ&Aを予定しています。

※ プログラムは変更となる可能性があります。

※ 外国語講演およびパネル・ディスカッションでは同時通訳が入りますので、日本語でご聴講いただけます。